

고순도 Ptfе 웨이퍼 세척 바스켓 내산성 실리콘 웨이퍼 캐리어 불소수지 에칭 랙

품목 번호: PL-CP284



소개

우리의 고순도 PTFE 웨이퍼 세척 바스켓으로 오염 없는 반도체 공정을 보장하세요. 강력한 에칭 및 세척을 위해 설계된 이 맞춤형 캐리어는 중요한 습식 화학 제조 공정 중 실리콘 웨이퍼 핸들링을 위한 탁월한 내화학성 및 열 안정성을 제공합니다.

자세히 알아보기

응용 분야	설명	주요 이점
RCA 표준 세척	실리콘 웨이퍼에서 유기 잔류물 및 금속 오염물을 제거하기 위한 순차적 SC-1 및 SC-2 세척 단계.	금속 이온 용출을 방지하여 초고순도 공정 환경을 보장합니다.
피라나 에칭	황산과 과산화수소 혼합물을 사용하여 중유기 물질 및 포토레지스트 제거.	열화 없이 극한의 발열 반응과 공격적인 산화를 견딥니다.
HF 딥/에칭	불산 용액을 사용하여 희생 산화막 또는 자연 산화막 제거.	유리나 석영 캐리어를 파괴할 HF 공격에 대한 완전한 면역성.
태양전지 텍스처링	빛 포획 표면 텍스처를 생성하기 위해 실리콘 웨이퍼를 알칼리 또는 산 용액에 침지.	대량 처리량 및 농축 KOH 또는 NaOH 용액에 대한 내성.
CMP 후 세척	화학 기계적 연마(CMP) 후 슬러리 입자 및 화학 잔류물 제거.	부착 방지 표면이 캐리어 및 웨이퍼에 슬러리 재침착을 방지합니다.
포토리소그래피	공격적인 유기 용제 및 현상액을 포함하는 현상 및 스트리핑 단계.	용제 내성 구조로 캐리어 재료의 팽창이나 연화가 없음을 보장합니다.
초음파 세척	수용액에서 민감한 전자 부품의 고주파 음향 세척.	초음파 에너지를 효과적으로 전달하면서 부품을 기계적 충격으로부터 보호합니다.
GaAs 공정	광전자 공학용 화합물 반도체 기판의 습식 화학 에칭 및 세척.	중요한 제조 단계 중 깨지기 쉬운 기판에 대한 부드럽고 안전한 지지.

매개변수	설명 / 사양 (PL-CP284 시리즈)
제품 품목 번호	PL-CP284
주요 재료	고순도 버진 PTFE (폴리테트라플루오로에틸렌)
화학적 호환성	범용 (강산, 염기, 용제, 산화제)
표준 웨이퍼 크기	4인치, 6인치 및 8인치 웨이퍼와 호환
맞춤화 옵션	완전히 맞춤화 가능한 치수, 슬롯 수 및 슬롯 너비
핸들 구성	고정식, 분리식 또는 로봇 호환 스타일 (맞춤화 가능)
작동 온도	-200°C ~ +260°C (연속)
표면 마감	고정밀 CNC 가공, 저기공성 표면
슬롯 설계	최소 접촉 면적을 위한 V자형 또는 맞춤형 프로파일
제조 공정	정밀도와 구조적 무결성을 위한 100% CNC 가공
순도 수준	미량 분석 등급, 무금속 제조